# 技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | | 昆山西微美晶电子新材料科技有限公司 | | | 机构代码 | | 066238978 | |
| 区 域 | | | | 昆山高新区 | 联系人 | 区科技局  路波（企业） | | 电话 | | 55171693  13862663908 |
| 行业领域 | | | | 新材料 | | | 产业领域 | | 新材料 | |
| 经济规模 | | | | 300万元 | | | 人员规模 | | 15人 | |
| **需求信息** | | | | | | | | | | |
| 需求名称 | | | 1、平板显示UV胶的研发和生产；  2、各向异性导电胶膜的研发和生产。 | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ■技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 技术需求：  1.平板显示UV胶的研发和生产，针对平板显示UV密封胶对气和水的阻挡特性的要求，需选用合适的树脂基体和固化体系，优化胶黏剂配方，达到国外同类产品水平。  2. 各向异性导电胶膜的研发和生产，以索尼和日立化学的同类产品为标杆，开发和生产出与国外产品性能媲美的各向异性导电胶膜，打破国外产品的垄断地位，促进国内平板显示行业健康发展。  3.针对智能卡和RFID行业，完善该领域UV填充胶、贴片胶、筑坝胶、各向异性导电胶水的优化和扩大规模生产。 | | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  技术需求：  1.平板显示UV胶的研发和生产，针对平板显示UV密封胶对气和水的阻挡特性的要求，需选用合适的树脂基体和固化体系，优化胶黏剂配方，达到国外同类产品水平。  2. 各向异性导电胶膜的研发和生产，以索尼和日立化学的同类产品为标杆，开发和生产出与国外产品性能媲美的各向异性导电胶膜，打破国外产品的垄断地位，促进国内平板显示行业健康发展。  3.针对智能卡和RFID行业，完善该领域UV填充胶、贴片胶、筑坝胶、各向异性导电胶水的优化和扩大规模生产。 | | | | | | | |
| 现有  基础  情况  现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  昆山西微美晶2013年4月在昆山注册成立，是一家从事微电子、半导体领域封装及导电材料的研发、生产及销售的高新技术企业(昆山工业技术研究院占股10%）。主要产品有芯片倒封装各向异性导电胶及胶膜、UV灌封胶，填补了我国在该领域的空白。  获得资质认证情况  2015年11月RFID芯片倒封装用异向性导电胶获得高新产品认定证书  2015年11月ACF异方性导电胶膜获得高新产品认定证书  2016年1月通过ISO9001认证  2017年4月产品通过SGS测试报告  由国家知识产权局颁发的专利证书：  专利名称：花状球形银粉的制备方法  专利名称：高振实球形银粉的制备方法  专利名称：快速固化的各项异性导电胶及其制备方法  地方政府的支持：  2014年12月与昆山市工业技术研究院联合成立智能卡及RFID电子封装材料测试实验室。同年，获得江苏省“博士聚集计划”，由昆山市科技局颁发“昆山市研发机构”并获得“江苏省民营科技企业奖。  2015年获得“昆山市双创高层次人才”和苏州市“姑苏双创人才领军人才”。同年，江苏省颁发“高新技术企业证书”，企业产品获得“高新技术产品认定证书”。 | | | | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  希望与科研院所开展产学研合作 | | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 ■科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ■是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ■是  □否 | | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ■是  □否 | | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | | |

**※请务必确认“同意公开需求信息”一栏填“是”**